

< 日本特許・実用新案明細書収録セット >

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

銀合金メッキ方法と浴の組成

[公開編] 平成5年～平成12年(8年間) 68点

***電子BOOK版新登場!** 全文PDF CD-ROM 版 ¥24,700 -
 全文紙収録 全文公報版 ¥24,700 -

既刊関連セットのご案内

No,9087	公開特許	プリント基板のメッキ処理装置	平.8-12	70点	¥27,700
No,8579	登録・公開	バレルメッキ方法と装置	平.9-10	76点	¥30,000
No,8084	公告・公開	"	平.7-8	73点	¥29,700
No,7797	"	"	平.5-6	66点	¥23,000
No,7558	"	"	平.3-4	109点	¥39,200
No,8641(B)	公開特許	電気めっき用治具とめっき方法	平.8-10	90点	¥31,300
No,"(A)	"	"	平.5-7	91点	¥31,000
No,8865	公告特許	"	平.6-11	80点	¥27,700
No,8863	"	リードフレームのメッキ方法と装置	平.6-11	53点	¥20,400
No,8868	公開特許	半導体ウェーハのメッキ方法と装置	平.5-11	103点	¥35,000
No,8926	"	半田メッキ方法と工程	平.5-11	75点	¥29,700
No,8496	"	ガラスへのメッキ処理方法	平.5-9	60点	¥23,700
No,8497	"	ハードディスク用基板のメッキ方法	平.5-9	66点	¥27,800
No,8929	"	メッキ前処理剤の組成と前処理方法	平.5-11	81点	¥31,600
No,8936	"	チタン合金の表面硬化方法	平.5-11	71点	¥26,700
No,8937	"	チタン材のエッチング方法と浴の組成	平.5-11	59点	¥24,500
No,8938(A)	"	チタンの着色加工方法	平.7-11	57点	¥22,400
No,8938(B)	"	チタンのメッキ加工方法	平.7-11	55点	¥21,600
No,8924	"	マグネシウム合金の表面処理方法	平.9-11	48点	¥19,300
No,8826	"	メッキ剥離剤の組成と剥離方法	平.9-11	67点	¥24,800

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります)

[原本コピーはB5サイズ・目次製本済みです。2～3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会 社 名	ご 注 文 内 容
	ニュースガイド No. CD-ROM版 ・ 全文公報版
所 属 部 署	題 名
担 当 者 名	合計 ¥
	() FAX ()
住所 〒	

銀合金メッキ方法と浴の組成

No, 9190

[公開編] 平成 5 年 ~ 平成 1 2 年 6 8 点

CD-ROM版 ¥24,700

全文公報版 ¥24,700

日本特許公開 平成 5 年

- 1 銀銅合金メッキ浴及び銀銅合金ロウ材
日本エレクトロレィティング・エンジニアズ(株)
- 2 電気デバイスの製造方法
アメリカン・テレフォン&テレグラフ Co.
- 3 貴金属めっき材の封孔処理方法 日鉱金属(株)
- 4 " " "
- 5 " " "
- 6 装飾部材 セイコ・エレクトロニクス(株)
- 7 " " "

日本特許公開 平成 6 年

- 8 電気メッキされた金 - 銅 - 銀の合金
リーロナル Inc.
- 9 リードフレーム 芦沢精一
- 10 電気接点材料とその製造方法 古河電工(株)
- 11 シアン化物を含まない 1 価金属のメッキ溶液
リーロナル Inc.

日本特許公開 平成 7 年

- 12 銀 - パラジウム合金めっきめっき方法およびめっき浴
住友金属工業(株)
- 13 銀 - 錫合金めっき沈着浴
ゲー・ツェー・ヘルス GmbH
- 14 金めっき装飾体の製造方法 吉野電化工業(株)
- 15 Sn - Zn 合金めっき上に高耐食性黒色皮膜を形成する方法
ディップソール(株)

日本特許公開 平成 8 年

- 16 光沢パラジウム系めっき浴およびめっき方法
住友金属工業(株)
- 17 半導体チップ実装用リードフレーム
古河電工(株)
- 18 耐熱銀被覆複合体とその製造方法 "
- 19 低融点錫合金めっき浴 荏原工業(株)
- 20 金属被覆粉体の製造方法 住友金属鉱山(株)
- 21 プリント回路板の製造 アルファ・メタル LTD
- 22 銀白色めっき皮膜形成方法ならびに銀白色めっき装飾品
大和特殊(株)
- 23 電気接点材料とその製造方法 古河電工(株)

日本特許公開 平成 9 年

- 24 すず・銀合金めっき浴
日本エレクトロレィティング・エンジニアズ(株)
- 25 無電解錫 - 銀合金めっき浴
(株)大和化成研究所
- 26 錫 - 銀合金電気めっき浴 "
- 27 錫 - 銀合金酸性めっき浴 ディップソール(株)
- 28 金属錯体形成用水溶液、錫 - 銀合金めっき浴およびこのめっき浴を用いためっき物の製造方法
長野県
- 29 銀 - 銀系合金めっき浴およびこのめっき浴を用いためっき物の製造方法 "
- 30 銀および銀合金めっき浴 荏原工業(株)
- 31 銀被覆バネ用りん青銅とその製造方法
古河電工(株)

- 32 電気接点用材料又は電気接点部品 古河電工(株)
- 33 半導体集積回路装置およびその製造方法
(株)日立s/s

日本特許公開 平成 10 年

- 34 パラジウム・銀合金めっき浴
日本エレクトロレィティング・エンジニアズ(株)
- 35 錫 - 銀合金電気めっき浴及び錫 - 銀合金電気めっき方法
上村工業(株)
- 36 光沢錫 - 銀合金電気めっき浴 石原薬品(株)
- 37 電気・電子回路部品 "
- 38 非シアン置換銀めっき浴 "
- 39 錫 - 銀合金めっき浴 (株)大和化成研究所
- 40 錫 - 銀合金酸性電気めっき浴
ディップソール(株)
- 41 被覆粉体、銀被覆銅粉及びその製造方法、導電性ペースト並びに導電膜
同和鉱業(株)
- 42 高速めっき装置及び高速めっき方法
日本エレクトロレィティング・エンジニアズ(株)
- 43 半導体リードフレーム 日本高純度化学(株)
- 44 電子部品 芦沢精一
- 45 耐摩耗性に優れた軸受 エヌデーシー(株)

日本特許公開 平成 11 年

- 46 めっき方法及びめっき物 石原薬品(株)
- 47 錫 - 銀合金めっき浴及びめっき物 "
- 48 銀及び銀合金メッキ浴 "
- 49 錫 - 銀系合金酸性電気めっき浴
ディップソール(株)
- 50 錫又は銀合金酸性電気めっき浴 "
- 51 錫 - 銀合金めっき浴用添加剤および該添加剤を含有する錫 - 銀合金めっき浴
I&Iケムキャット(株)
- 52 錫 - 銀合金電気めっき浴 キザイ(株)
- 53 銀めっき浴及び銀 / すず合金めっき浴並びにそれらのめっき浴を用いるめっき方法
工業技術院
- 54 電気・電子部品用材料とその製造方法、その材料を用いた電気・電子部品 古河電工(株)
- 55 " " "
- 56 錫 - 銀はんだ合金めっき層の形成方法
日鉱金属(株)
- 57 高速メッキ装置及び高温メッキ方法
日本エレクトロレィティング・エンジニアズ(株)
- 58 銅剥離剤およびその銅剥離剤を用いた銅剥離方法
"
- 59 金属被覆部材 古河電工(株)
- 60 電気・電子部品用材料とその製造方法、およびその材料を用いた電気・電子部品 "

日本特許公開 平成 12 年

- 61 銀及び銀合金メッキ浴 石原薬品(株)
- 62 無電解スズ - 銀合金メッキ浴及び当該メッキ浴でスズ - 銀合金皮膜を施した TAB のフィルムキャリア等
"

- 以下 6 点省略 -